公司代码：603501　　公司简称：韦尔股份
转债代码：113616　　转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案为：公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），预计分配现金红利总额为 455,376,768.60 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.17%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股，预计转增 306,503,595 股。

公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任冰	周舒扬
办公地址	上海市浦东新区上科路 88 号东楼	上海市浦东新区上科路 88 号东楼
电话	021-50805043	021-50805043
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com	will_stock@corp.ovt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

（二）行业发展情况

1、全球半导体行业发展情况

在半导体市场需求旺盛的引领下，2021 年全球半导体市场高速增长。根据全球半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元，同比增长 27.1%。

根据 WSTS 统计情况，2021 年各细分业务领域均表现出了较强的增势，增加率最高的是模拟产品 33.1%，其次是内存 30.9%和逻辑 30.8%。WSTS 预计 2022 年全球半导体市场将继续增长，全球半导体市场将增加 10.4%，销售额将达到 6,135 亿美元，其中传感器、逻辑、模拟设备将是市场增长的主要动力。

2、中国半导体行业发展情况

2021 年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长 19.6%；制造业销售额为 3,176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额 2,763 亿元，同比增长 10.1%。

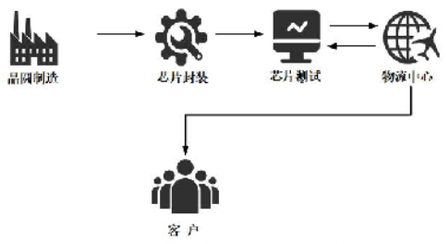
2021 年中国集成电路产品进出口都保持较高增速，根据海关统计，2021 年中国进口集成电路 6,354.8 亿块，同比增长 16.9%；进口金额 4,325.5 亿美元，同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3,107 亿块，同比增长 19.6%，出口金额 1,537.9 亿美元，同比增长 32%。

公司一直从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。伴随着公司近年来收购整合的顺利完成，公司半导体产品设计业务形成了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大核心业务体系，并通过团队扩充及并购延伸等方式不断丰富公司产品版图。同时，公司作为国内主要半导体产品分销商之一，凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系，同全球主要半导体供应商及国内各大模组厂商及终端客户继续保持着密切合作。

（一）半导体设计业务

1、公司采用 Fabless 的业务模式

公司半导体设计业务属于典型的 Fabless 模式，公司仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试。



公司生产芯片的原材料主要为晶圆。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，与公司有着长期稳定的合作关系，产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广，根据行业、产品及市场需求情况，公司相应选择直销和代销的方式进行销售。总体而言，公司的销售模式以直销为主、代销为辅。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM 厂商、OEM 厂商及终端客户，直销模式可以保障公司服务效率，根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外，公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式，公司可有效降低新客户开发的成本，在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时，也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

2、公司设计业务产品类型

目前公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。具体产品包括以下部分：

业务	产品名称	主要功能	应用领域
图像传感器解决方案	CMOS 图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号，是数字摄像头的重要组成部分	消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等
	微型影像模组封装（CameraCubeChip）	采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案，可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、物联网、眼球追踪、AR/VR 等
	硅基液晶投影显示（LCOS）	反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器，微型投影、汽车、医疗等
	特定用途集成电路产品（ASIC）	支持公司 CMOS 图像传感器，在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用，提供 USB、并行、串行接口解决方案以及压缩引擎和低功耗图像信号处理等功能	汽车、安防等
触控与显示解决方案	触控和显示驱动集成芯片（TDDI）	接收手机主机输出的图像数据，驱动 LCD 屏显示，并且侦测用户触控信号进行与智能手机的人机交互	智能手机
	显示驱动芯片（DDIC）	负责驱动显示器和控制驱动电流等功能，实现对显示屏成像系统的控制	智能手机
模拟解决方案	TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
	MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	肖特基二极管	电源整流，电流控向，截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
	DC-DC	起调压的作用（开关电源），同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等
	LED 背光驱动	构造一个恒流源电路，确保任何条件下背光 LED 的发光光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等
	模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	射频芯片	信号放大、信号传输	移动通信

（二）半导体产品分销业务

1、半导体产品分销业务模式

公司作为典型的技术型半导体授权分销商，与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的 FAE 队伍，顺应国内半导体行业的产业地域布局，公司分销体系境内外多地设立了子公司，构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式，具体分为境内采购和境外采购两部分：①境内采购主要由北京京鸿志及其他子公司在境内进行；②境外采购主要由香港华清及其他子公司在境外进行。

基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析，公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好的了解客户的需求，进而使得公司研发设计业务下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品的理解及需求，代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

2、半导体分销业务产品类型

分销的产品可分为电子元件、结构器件、分立器件、集成电路、显示屏模组等，覆盖了移动通信、家用电器、安防、智能穿戴、工业设备、电力设备、电机控制、仪器仪表、汽车部件及消防等诸多领域。

产品名称	细分产品	主要代理原厂
电子元件	电阻、电容、电感等	松下、乾坤、国巨、三星、华新科、华德等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB 等	Molex、松下、南亚、NIDEC、台达等
分立器件	光电半导体器件、晶振、半导体等	光宝、TXC、TSC、APS 等
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash 等	光宝、江波龙、XMC、昆腾微、长工微、景略、荣湃、力生美、芯昇、前海维晟、海标创、爱芯、九天睿芯、国民技术等
射频器件	滤波器等	松下、ACX、佳利、芯朴、华新科、新声等
显示屏模组	PMOLED、LCM、AIT 等	智晶、LGD 等

公司根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素，对所代理的产品线进行动态管理。半导体分销业务是公司了解市场需求的重要信息来源，在维持现有的半导体分销业务销售规模的背景下，公司将下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系，及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求，有针对性的进行技术研发和储备，使企业的新技术能顺应市场变化，减少下游行业变化带来的负面影响，助力公司半导体设计业务迅速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	32,079,927,549.91	22,647,992,328.94	41.65	17,476,223,432.68
归属于上市公司股东的净资产	16,198,313,972.34	11,238,642,949.21	44.13	7,926,394,295.30
营业收入	24,103,509,570.58	19,823,965,431.66	21.59	13,631,670,629.57
归属于上市公司股东的净利润	4,476,187,473.66	2,706,109,337.61	65.41	465,632,238.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,002,881,410.48	2,245,073,139.31	78.30	334,201,677.11
经营活动产生的现金流量净额	2,192,411,060.29	3,344,594,067.54	-34.45	805,335,234.79
加权平均净资产收益率(%)	33.06	29.06	增加 4.00 个百分点	10.17
基本每股收益(元/股)	5.16	3.21	60.75	0.76
稀释每股收益(元/股)	5.14	3.19	61.13	0.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	6,211,809,017.73	6,236,334,919.72	5,866,326,033.32	5,789,039,599.80
归属于上市公司股东的净利润	1,040,832,170.26	1,202,717,165.29	1,274,934,995.81	957,703,142.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	944,202,864.02	1,021,651,349.92	1,101,969,114.49	935,058,082.05
经营活动产生的现金流量净额	482,416,923.01	627,592,842.77	1,400,820,688.21	-318,419,393.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

3

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

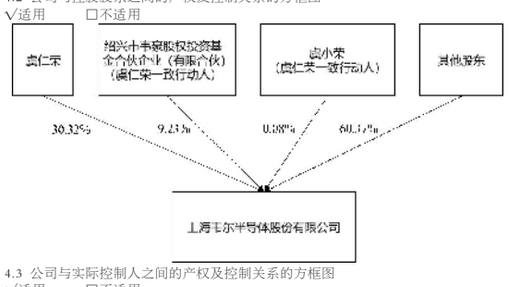
截至报告期末普通股股东总数(户)	42,090
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,239
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
虞仁荣	-13,900,000	265,535,000	30.32	0	质押	102,022,000	境内自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	80,839,009	9.23	80,839,009	质押	40,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	30,213,798	75,194,867	8.59	0	无	0	境外法人
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	-20,353,937	23,654,064	2.70	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	-7,540,209	14,826,129	1.69	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	-8,949,624	13,446,718	1.54	0	无	0	境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	-4,787,499	9,314,814	1.06	0	无	0	境内非国有法人
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙)	-881,500	8,950,460	1.02	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	-5,300,905	8,750,459	1.00	0	无	0	境内非国有法人
Seagull Strategic Investments(A3), LLC	-13,561,799	8,489,711	0.97	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人；嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、北京华清博广创业投资有限公司均为吕大龙先生控制的企业，嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、北京华清博广创业投资有限公司互为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

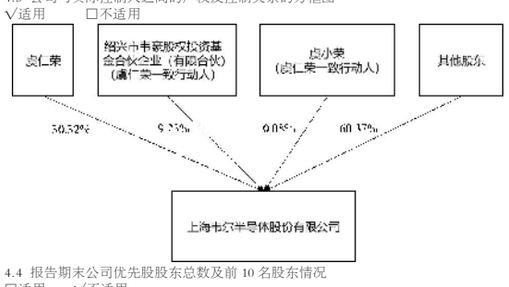
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

√适用　　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
长三角科创企业 2020 年度第一期集合短期融资券	20 长三角科创集合 CP001	042000465	2021 年 10 月 30 日	0	3.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
长三角科创企业 2020 年度第一期集合短期融资券	公司参与的长三角科创企业 2020 年度第一期集合短期融资券于 2020 年 10 月 29 日成功发行，本期短期融资券集合发行总额为人民币 5 亿元，其中公司发行金额为人民币 2 亿元，票面利率为 3.30%，期限为 365 天，起息日期为 2020 年 10 月 30 日，兑付日期为 2021 年 10 月 30 日。公司已完成本期短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币 20,660 万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　　□不适用

单位：万元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.18	49.11	0.07
扣除非经常性损益后净利润	400,288.14	224,507.31	78.30
EBITDA 全部债务比	40.19%	34.79%	15.52
利息保障倍数	13.19	9.04	45.91

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内，公司营业总收入 241.04 亿元，较 2020 年增长 21.59%；公司归属于母公司股东的净利润为 44.76 亿元，比 2020 年增长 65.41%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

公司代码：603501　　公司简称：韦尔股份　　公告编号：2022-032
转债代码：113616　　转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 关于重大资产重组标的资产 2021 年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1001 号），核准公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 39 名交易对方发行股份购买其持有的北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）85.53%的股权、北京思比科微电子技术股份有限公司（现已更名为“豪威科技（北京）股份有限公司”，以下简称“思比科”）42.27%的股权、北京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）79.93%的股权并非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元（以下简称“本次重大资产重组”），公司于 2019 年 8 月完成了本次重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，现就 2021 年度本次重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况说明如下：

一、本次重大资产重组基本情况

1、2018 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组事项。2018 年 12 月 17 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过本次重大资产重组方案及相关议案。

2、2019 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1001 号），核准公司向交易对方合计发行 400,951,447 股股份购买资产，并非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。

3、2019 年 7 月 30 日，北京豪威 85.53%的股权、思比科 42.27%的股权、视信源 79.93%的股权已过户至公司名下，相关工商变更手续已办理完成。

4、2019 年 8 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海韦尔半导体股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15325 号），截至 2019 年 7 月 30 日止，上海韦尔半导体股份有限公司已取得北京豪威 85.53%股权、思比科 42.27%股权、视信源 79.93%股权，上述公司股权已过户至韦尔股份名下，并完成了相关股权变更登记手续。变更后的注册资本为人民币 856,655,387.00 元，变更后的股本为人民币 856,655,387.00 元。

5、2019 年 8 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海韦尔半导体股份有限公司验资报告（截至 2019 年 8 月 21 日）》（信会师报字[2019]第 ZA15427 号），确认截至 2019 年 8 月 21 日止，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除发行费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元，其中，计入股本金额为人民币 7,006,711.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币 359,849,241.05 元。变更后公司的注册资本为人民币 863,662,098.00 元，股本为人民币 863,662,098.00 元。

6、2019 年 8 月 28 日，公司已完成本次发行股份购买资产的新增限售流通股 400,951,447 股的股份登记以及非公开发行股份募集配套资金的新增限售流通股 7,006,711 股的股份登记。公司已于当日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

二、业绩承诺情况

（一）北京豪威业绩承诺情况

根据本公司与北京豪威业绩承诺方绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴韦豪”）、青岛融通民和投资中心（有限合伙）、Seagull Strategic Investments (A3), LLC、嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、Seagull Investments, LLC、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、共青城威熠投资有限公司、Seagull Strategic Investments (A1), LLC、Seagull Equity Investments (C1-Int'l) (Hong Kong) Limited、Seagull Equity Investments (C1), LLC、虞仁荣签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京豪威科技有限公司部分股东及虞仁荣之利润补偿协议》，北京豪威 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数（指北京豪威在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于 54,541.50 万元、84,541.50 万元及 112,634.60 万元。

2019 年 5 月 17 日，承诺方虞仁荣和绍兴韦豪分别出具了《关于补充利润补偿的承诺函》，承诺虞仁荣和绍兴韦豪将按照《利润补偿协议》列明的承诺净利润数与北京豪威技术研发材料费用资本化对当期净利润的预测影响金额之和作为新的承诺净利润数，具体为北京豪威 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数不低于 59,938.87 万元、88,481.57 万元及 115,146.55 万元。

（二）思比科业绩承诺情况

根据本公司与思比科业绩承诺方北京华清博广创业投资有限公司、吴南健、陈杰、刘志碧签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京思比科微电子股份有限公司部分股东之利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，思比科 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数（指思比科在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于 2,500 万元、4,500 万元及 6,500 万元。

（三）视信源业绩承诺情况

根据本公司与视信源业绩承诺方陈杰、刘志碧、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、吴南健签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京视信源科技发展有限公司部分股东之利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，视信源 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数（指视信源在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于 1,346 万元、2,423 万元及 3,500 万元。

三、业绩承诺实现情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司净利润实现数与净利润承诺数差异情况说明及专项审核报告》（普华永道中天特审字(2022)第 3596 号）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司购买标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》信会师报字[2022]第 ZA11027 号，公司重大资产重组标的资产 2021 年度业绩承诺实现情况如下：

（一）北京豪威业绩实现情况

剔除配套募集资金产生的影响，北京豪威 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 318,416.43 万元，2021 年度的净利润实现数已实现净利润承诺数，对于虞仁荣及绍兴韦豪实现率为 276.53%，对于除虞仁荣及绍兴韦豪外其他承诺方实现率为 282.70%。

（二）思比科业绩实现情况

思比科 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 13,702.17 万元，2021 年度的净利润实现数已实现净利润承诺数，业绩承诺方业绩实现率为 210.80%。

（三）视信源业绩实现情况

视信源 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,374.13 万元，2021 年度的净利润实现数已完成净利润承诺数，业绩承诺方业绩实现率为 210.69%。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

公司代码：603501　　公司简称：韦尔股份　　公告编号：2022-038
转债代码：113616　　转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海韦矽微电子有限公司（以下简称“上海韦矽”）、北京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、深圳市京鸿志电子科技有限公司（以下简称“深圳京鸿志”）、深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“京鸿志物流”）、上海灵心电子科技有限公司（以下简称“上海灵心”）、香港华清电子（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）、韦尔半导体香港有限公司（以下简称“韦尔香港”）、豪威科技（北京）股份有限公司（以下简称“思比科”）、思比科（香港）有限公司（以下简称“香港思比科”）、OmniVision Technologies, Inc.（以下简称“美国豪威”）、香港灵心电子科技有限公司（以下简称“香港灵心”）、香港东意电子有限公司（以下简称“香港东意”）、上海豪威集成电路集团有限公司（以下简称“上海豪威”）、OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd（以下简称“新加坡豪威”）。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2022 年度公司为控股子公司提供担保额度为不超过 73 亿元的人民币及外币融资；截止本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额约为人民币 14.58 亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项已履行的内部决策程序

2022 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 73 亿元，提请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。在公司 2022 年年度股东大会召开前，公司为子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	持股比例	主营业务	注册资本（万元）	2021.12.31 总资产（万元）	2021.12.31 净资产（万元）	2021 年 净利润（万元）
上海韦矽	韦尔股份 100%	集成电路及软件的开发、设计、销售与测试，计算机领域的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。	2,000.00	81,014.32	2,581.76	769.35
北京京鸿志	韦尔股份 100%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备(不含汽车租赁)。	43,000.00	126,897.86	70,497.79	23,494.27
深圳京鸿志	北京京鸿志 100%	电子产品的销售，国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-4976 号经营)。	4,000.00	36,519.36	13,514.46	5,817.53
京鸿志物流	北京京鸿志 100%	国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。	8,000.00	79,798.87	13,991.57	5,399.16
韦尔香港	韦尔股份 100%	集成电路产品之分销及进出口	（港币）6,860.00	235,657.97	-7,308.14	-19,673.79
香港华清	韦尔香港 100%	国际贸易	（港币）10,000.00	108,315.65	37,953.78	12,212.98
上海灵心	韦尔股份 100%	从事电子科技、网络科技、信息科技、通讯科技、电气科技、新能源科技、智能科技、环保科技、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、机电设备、电气设备、电子元器件、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、仪器仪表、钟表、智能设备的销售、从事货物及技术的进出口业务。	800.00	1,541.01	929.10	45.81
北京思比科	韦尔股份 96.12%	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；销售(不含零售)计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	5,250.00	76,610.42	31,646.99	13,994.22
香港思比科	北京思比科 100%	集成电路产品设计、研发、销售	（美元）30.00	2,819.76	2,232.14	1,166.95
美国豪威	Seagull International limited 100%	设计、生产及销售高性能、高集成及高性价比半导体图像传感器设备	1 股普通股(每股面值 1 美元)	1,279,810.77	1,659,261.18	52,048.95
香港灵心	上海灵心 100%	电子元器件销售	（港币）100.00	679.47	-524.66	-129.74
香港东意	深圳东益 100%	电子元器件销售	（港币）100.00	5,766.13	-358.61	-81.16
上海豪威	韦尔股份 100%	集成电路设计；集成电路销售；从事集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；销售、技术转让；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	50,000.00	5,471.65	4,218.53	-3,558.91
新加坡豪威	OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited 100%	半导体产品设计及销售	（美元）50.00	140,196.67	521,503.65	37,806.64

（二）上述被担保人均为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

1、担保方式：由公司和 / 或公司控股子公司以连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式为被担保人提供担保。

2、担保金额：总计不超过等值人民币 73 亿元的人民币及外币融资

各子公司担保额度分配如下：

序号	被担保人公司名称	担保额度(亿元)
1	上海韦矽微电子有限公司	1.00
2	北京京鸿志科技有限公司	3.00
3	深圳京鸿志电子科技有限公司	0.50
4	深圳市京鸿志物流有限公司	2.00
5	上海灵心电子科技有限公司	0.05
6	香港华清电子(集团)有限公司	3.10
7	韦尔半导体香港有限公司	3.10
8	北京思比科微电子技术股份有限公司	2.00
9	思比科(香港)有限公司	0.15
10	OmniVision Technologies, Inc.	28.00
11	香港灵心电子科技有限公司	0.05
12	香港东意电子有限公司	0.05
13	上海豪威集成电路集团有限公司	10.00
14	OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.	20.00
合计		73.00

3、上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，各控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

4、在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监审批在额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

5、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

6、在 2022 年年度股东大会召开日前，本公司和 / 或公司控股子公司为上述被担保人在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

上述计划担保总额仅为公司 2022 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司 2022 年度为控股子公司提供担保是考虑公司控股子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保事项。

公司独立董事认为：公司 2022 年度提供担保的对象均为合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司